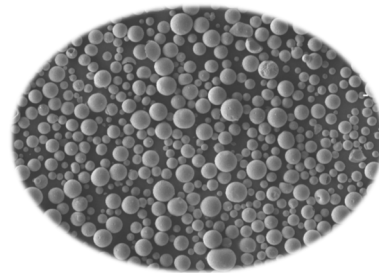


開発品 軟磁性フェライト材料

球状ソフトフェライト



概要

自社製造のフェライトを用いた球状粒子を開発しました。球状ソフトフェライトは真球状であり、かつ表面平滑性が高いことから、樹脂への充填性および分散性に優れた特性を有しています。樹脂に分散させるフィラーとして最適で、磁気シールド材料や回路基板用途などでお使いいただけます。

特徴

樹脂への高い充填性

球形度が高く表面平滑性が高いため、樹脂への充填性に優れています。

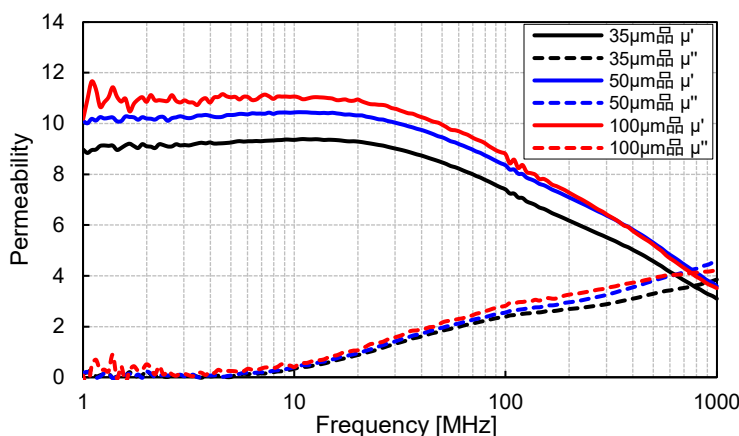
ニーズに合わせた磁気特性

粒子サイズや組成などの物性を制御することで、ご希望の磁気特性に対応する粉末を提供します。

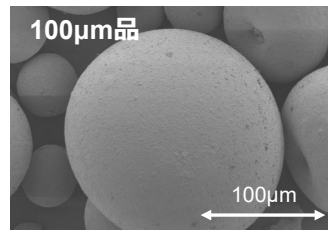
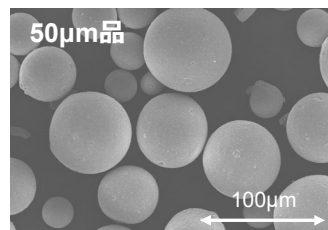
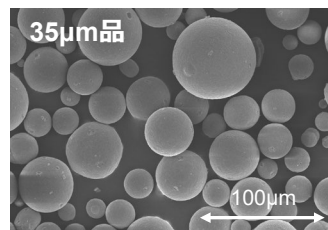
開発品情報

【代表サンプルの特性】

タイプ		35μm品	50μm品	100μm品
ソフトフェライトの組成		Ni-Zn系	Ni-Zn系	Ni-Zn系
粒度分布	D10 [μm]	25.0	30.3	70.0
	D50 [μm]	36.7	50.4	111.0
	D90 [μm]	53.6	80.5	170.0
透磁率 (樹脂に60vol%充填)	μ' at 50MHz [-]	8.5	9.5	10.0
	μ' at 100MHz [-]	7.4	8.4	8.8
磁気特性 (樹脂に60vol%充填)	飽和磁化 [mT]	256	239	192
	残留磁化 [mT]	7.4	6.8	5.8
	保磁力 [kA/m]	1.4	1.4	1.3



【透磁率周波数特性(樹脂に60vol%充填)】



【球状ソフトフェライトのSEMイメージ】

用途

- ノイズ抑制材
- 回路基板
- 半導体封止材

戸田工業株式会社 東京オフィス

〒108-0014 東京都港区芝5丁目13-15 芝三田森ビル6階, Tel 03-5439-6040, E-mail: webmaster@todakogyo.co.jp

本資料に記載したデータは保証値ではありません。また記載内容については、改良などの事由により予告なく変更する場合があります。

